# 取扱製品

事業領域	取扱製品群			
半導体	● ウェハーテスト チップテスト [山梨·東北]	<ul><li>ロジック ● アナログ ● RF</li><li>ドライバー ● MOSFET ● IGBT</li></ul>		
	● ノンリードパッケージ [東北·山梨]	<ul><li>SON ●QFN</li><li>リードフレームモジュール</li></ul>		
	<ul><li>車載パッケージ</li><li>[山梨·東北]</li></ul>	<ul><li>SOP ●パワーPKG</li><li>パワーモジュール ●SON/QFN</li></ul>		
	●フィルムデバイス [山梨]	•TCP •COF		
	<ul><li>● チップ加工 (車載ペアダイ)</li><li>[山梨]</li></ul>	<ul><li>WCSP ● 車載ベアダイ</li><li>Sawn ● T&amp;R ● トレイ</li></ul>		
	●外装半田めっき			
電子部品	● タイミングデバイス [山梨]			
	●めっき応用製品			
	<ul><li>● 伝送デバイス</li></ul>			
	・センサー			
医療機器	● メディセーフ針 ● ベノジュ (医療機器製造業許可証 許可番号			

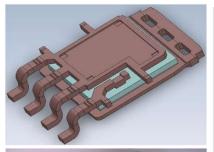
## 加藤電器製作所の特徴

## FAによる高速処理、省人化を推進することで コスト追求、品質への人的影響を最小限にしたもの造りをご提案し 国内での受託生産事業を展開しております

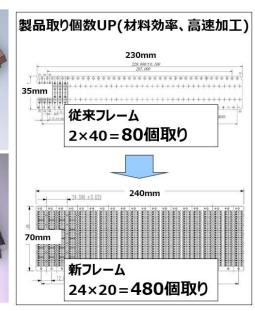
■製品共同開発 : パッケージ設計、材料・工法開発、試作、信頼性評価

■自動化検討:工程設計、工程集約、要素技術開発、材料効率

■量産設備開発 : カスタム設備構想、立上げ評価、量産導入















パッケージ開発

効率化/工法開発

カスタム設備制作・立上げ

# 加藤電器の実装技術

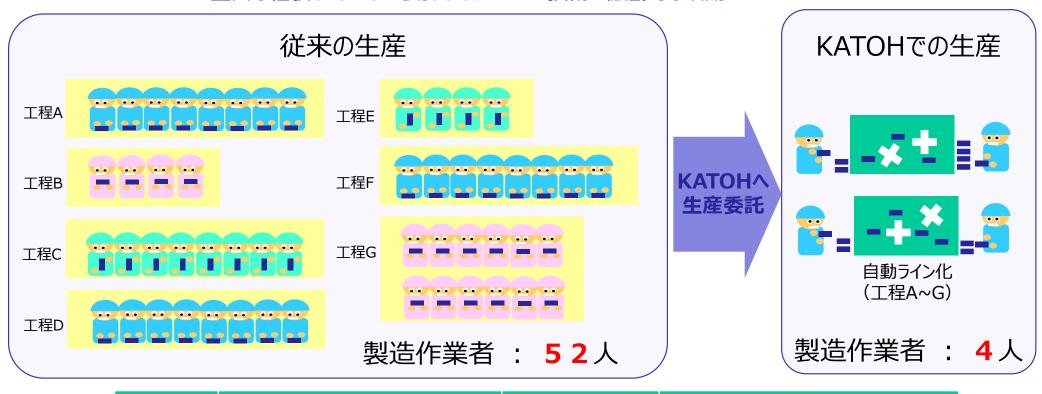
#### 要素技術の組み合わせで、様々な実装案件に取り組みます

Cuワイヤー	AIワイヤー	特殊ワイヤー	クリップボンド	フリップチップボンド	高精度マルチボンド
	TERVAT CO. MASS CEL.			28. Ozn	
マルチチップ		部品積層	SMT実装	MEMS実装	
1 Am 23 5			90.5		
高放熱	透明	樹脂	開口	異形モールド	小型受動部品
1 to			•		2 sands
COL	構造	ダイパット	シス構造	LFモジュール	光デバイス実装
16 GAV 19 Surve 100 EE					

### 受託生産とFA技術のコラボレーション

#### 製品開発~生産ラインの構想・構築~生産受託を一貫で実現

- ▶ もの造りを考慮した製品開発から生まれた合理的な工程設計と自動化ラインの構築
- ▶ 豊富な経験とノウハウに裏打ちされたFA技術の徹底的な活用



	従来の生産方式		加藤電器が実現する生産方式
・作業内容	治具による人手の作業	Λ.	装置による自動化
・工程	全7工程		全3工程
·TAT	20日		10日
・スペース	8 0 m		2 0 m²
・人員	52人	V	4人
・省エネ	100KW		3 0 KW